

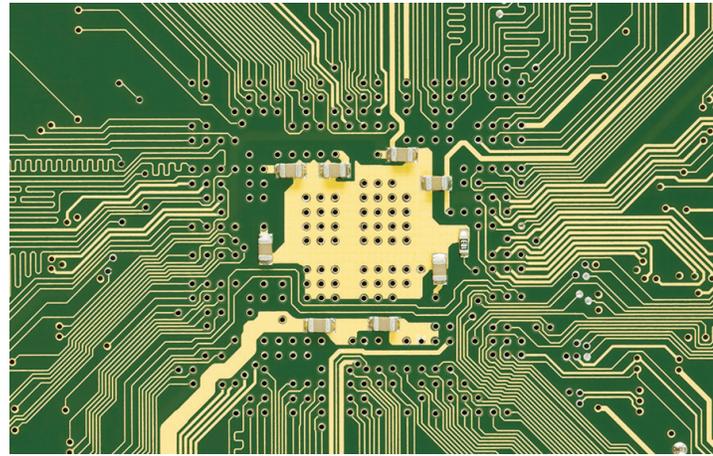
Affinity 2.0

化学沉镍金最终表面处理

预防过度腐蚀, 达致最佳信赖性

先进的技术往往增加工艺的难度和操作的复杂性, 但卓越设计的技术理念则能同时更好的融合先进的工艺, 展现出简易的操作。基于这一先进的设计理念, 行业领先的MacDermid Alpha 开发了Affinity 2.0。结合MacDermid Alpha原有的沉镍金技术、强大的专业研发和应用团队, 成就了这新一代Affinity 2.0的诞生。这项的技术, 能为客户带来极其稳定的流程和低腐蚀性的化学沉镍金系统。最重要的是, Affinity 2.0能减少了沉镍金流程里各项化学参数的变动, 稳定的活化和化镍药水促使沉积的镍层性能稳定一致, 从而令之后的沉金厚度展现出良好的均匀性。除此之外, 稳定的药水也能减少保养频率和额外劳动成本, Affinity 2.0 在操作过程中无须起镀步骤, 也节省了大量的拖缸板。

MacDermid Alpha Electronics Solutions 支持网路遍布全球, 致力于在电子制造业供应链提供降低工艺流程变数的解决方案, 终端客户都视我们为重要的合作伙伴。Affinity 2.0 沉镍金工艺就是一个很好的例子, 它能完全满足终端客户对产品“高性能、零变数”的要求, 也能协助线路板厂成为其终端客户优秀的供应商。



主要特性优点

- 在工艺研发与操作上应用六西格玛工具, 去芜存菁, 将潜在在沉镍金工艺内的缺陷排除
- 稳定一致的低化学镍腐蚀表现, 完全符合IPC4552A规范的最高要求
- 无需拖缸镀操作, 节省拖缸板成本和生产时间
- 与竞争对手的化学沉镍金系统相比, 金分布显着改善, 提供了卓越的焊锡性
- 镍槽溶液寿命长, 于寿命周期内沉积的镍层磷含量保持一致



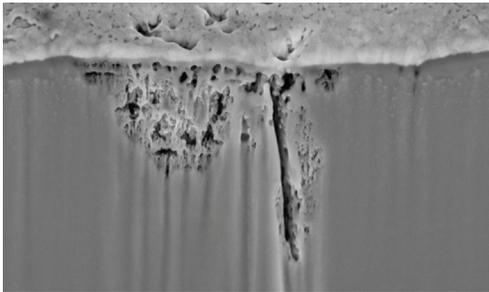
MacDermid Enthone

Affinity 2.0

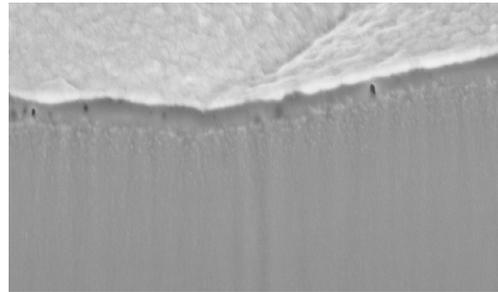
化学沉镍金最终表面处理

其他化学沉镍金工艺都只声称能预防止过度镍腐蚀。 而 Affinity 2.0 却已经是真正做到了！

MacDermid Alpha 的 Affinity ENIG 2.0 沉镍金的每个步骤 - 从前处理和活化, 到简单易用的化学镍和低腐蚀沉金 - 药水配方都是经过精密设计, 以达致能互相配合, 发挥相辅相成的作用, 制造出可靠性高而又稳定一致的沉镍金镀层。这一特征保障客户每次制造的、送出的每一片沉镍金板都具有极高的可靠性。



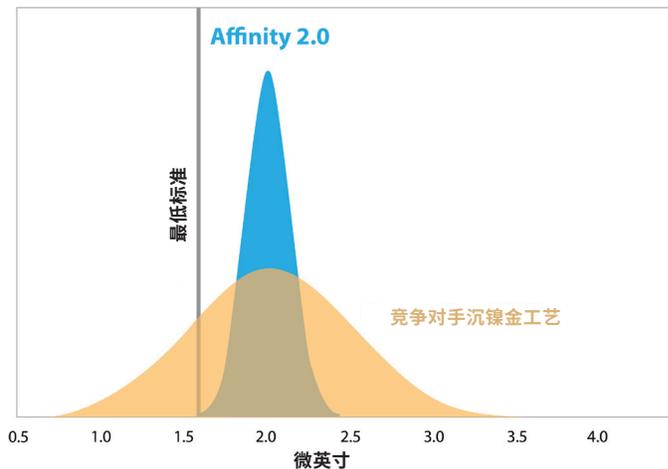
传统的沉镍金工艺往往都出现镍磷含量不一致的问题, 导致局部位置出现过度镍腐蚀的问题。



Affinity 2.0 沉镍金工艺在镍槽寿命周期内可能稳定一致的保持镍层磷含量约在9%。这高效防腐的镍层, 再配合低腐蚀性的 Affinity 2.0 Gold 沉金系统, 使镍层的腐蚀状况能保持一致的低, 消除局部位置过度腐蚀的忧虑。

稳定和一致性能产生高价值

Affinity 与竞争对手的工艺变异性比较



Affinity ENIG 2.0 能做出稳定和一致的低镍腐蚀, 具备高效和可靠性的沉镍金涂层, 绝对是线路板制造商的最佳选择。如需更详细的资料, 请联系 MacDermid Alpha 代表或立即访问 AffinityENIG.com



macdermidalpha.com
October, 2019

MacDermid Enthone is a product brand of MacDermid Alpha Electronics Solutions.

© 2019 MacDermid, Inc. and its group of companies. All rights reserved.

® and ™ are registered trademarks or trademarks of MacDermid, Inc. and its group of companies in the United States and/or other countries.

CIRCUITRY SOLUTIONS